

連結経営の強化に向け、グループ会社の再編を推進

2005年2月25日

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：林 将章／以下、日立ハイテク）は、高成長企業に向け従来より経営の効率化、スピード向上を目指してさまざまな経営改革に取り組んできました。

今回その一環として、2005年4月1日付けで情報事業、保守・サービス事業、磁気ディスク装置事業、アプリケーション開発事業、科学機器事業の5事業において、国内外グループ会社の再編を行い、一層の連結経営の強化と企業価値の向上を図ります。

情報事業では、（株）日立ハイテクソリューションズ、日立計測器サービス（株）、（株）日立サイエンスシステムズ等の国内グループ会社5社に分散している情報機器・部品・システム設計等の製造・販売・設計・サービス事業を、システム設計専門会社である日立ハイテクソリューションズに統合します。これにより、日立ハイテクソリューションズは当社グループにおける情報ソリューションビジネスの拠点として事業強化を図るとともに、B2Bサイトの構築・運用サービス事業への発展を目指します。

保守・サービス事業においては、日立ハイテク製品の保守・据付および部品販売などを手掛ける日立計測器サービス（株）が同社100%子会社であるヒスコソリューション（株）を吸収合併し、高品質で均一なサービスの提供による一層のCS向上とサービス効率の向上、コスト削減を目指します。

磁気ディスク装置事業では、米国の電子デバイスシステム事業を行っているアメリカ日立ハイテクノロジーズ会社が、米国での磁気ディスク製造・検査装置等の販売および保守サービスを手掛ける日立エレクトロニクスエンジニアリング（アメリカ）会社を統合し、同事業における営業力の強化と新規顧客開拓の促進を図ります。

アプリケーション開発事業では、日立ハイテクの那珂事業所、研究開発本部、（株）日立サイエンスシステムズに分散しているアプリケーション開発およびデモ機能を那珂事業所（茨城県ひたちなか市）に集約します。さらに、（株）日立サイエンスシステムズが行っているソフトウェア開発におけるシステム設計・機能設計も併せて那珂事業所に集約し、半導体関連装置とライフサイエンス関連装置のアプリケーション開発および製品開発力の強化を図ります。

科学機器事業では、本年1月25日に開示のとおり、電子顕微鏡や先端バイオ製品、一般分析機器等の直接販売・特約店ルート販売を行っている（株）日製サイエンスを日立ハイテクが吸収合併し、営業力の強化と顧客ニーズに合致した新製品開発力の強化を図ります。

日立ハイテクは、グループでの共通目標として「ハイテクソリューション事業におけるグローバルトップを目指す」という企業ビジョンを掲げ、経営改革を積極的に推進しています。

今回の再編もその一環として行うもので、グループ内の機能を集約することで営業力、開発力、提案力を強化し、効率的な連結経営により事業基盤の強化と事業規模の拡大を目指します。

ご参考：各事業を承継するグループ会社の概要

（1）情報事業

<（株）日立ハイテクソリューションズの概要>

本社所在地	神奈川県川崎市幸区堀川町580
代表者	取締役社長 奥山 至
設立年月	1983年10月
資本金	1億円
出資比率	日立ハイテク（100%）
主な事業	ソフトウェアの開発、情報処理機器の販売
売上高	53億円（2004年3月期）
従業員	223名（2004年3月末現在）

(2) 保守・サービス事業

<日立計測器サービス（株）の概要>

本社所在地	東京都新宿区四谷4-28-8
代表者	取締役社長 前田芳夫
設立年月	1965年4月
資本金	10億円
出資比率	日立ハイテク（100%）
主な事業	半導体製造装置・医用機器の保守および部品販売
売上高	392億円（2004年3月期）
従業員	886名（2004年3月末現在）

(3) 磁気ディスク装置事業

<日立計測器サービス（株）の概要>

本社所在地	米国 イリノイ州
代表者	取締役社長 紅林 實
設立年月	1969年4月
資本金	1,500万米ドル
出資比率	日立ハイテク（53%）、日立アメリカ（47%）
主な事業	半導体製造装置・科学機器等の販売
売上高	1,045百万米ドル（2004年3月期）
従業員	480名（2004年3月末現在）

以上

お問合せ先

お問い合わせ頂く前に、当社「[個人情報保護について](#)」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。当社「[個人情報保護について](#)」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社日立ハイテクノロジーズ
総務部 芥川、塩澤
電話：03-3504-5637